

上海新阳半导体材料股份有限公司

关于向银行申请授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、情况概述

上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 22 日召开第四届董事会第二十次会议审议通过《关于向银行申请贷款授信额度的议案》。随着公司规模不断扩大及研发项目投入的持续增加，根据实际发展需要，公司向合作的商业银行申请总额不超过 1.5 亿元的综合授信（最终以银行实际审批的授信额度为准），用于公司流动资金贷款、开立银行承兑汇票等，授信期限为 2 年，授信期限内额度可循环使用。实际融资金额应以相关银行与公司实际发生的贷款金额为准。在上述贷款授信额度内，董事会授权董事长王福祥先生代表公司签署相关法律文件。

本次申请银行授信额度无需提交公司股东大会审议。如根据银行最终审批结果，授信事项涉及担保或关联交易等，应根据担保或关联交易等具体情况，按照公司章程规定的审议权限履行相应审议程序后方可实施。

二、备查文件

1. 上海新阳半导体材料股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议。
2. 上海新阳半导体材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海新阳半导体材料股份有限公司董事会

2021 年 1 月 22 日